

次世代半導体向けのシンタリング事業で、 Boschman社（オランダ）と進和が協業

～ SiC・GaN半導体 × シンタリング接合で、パワー半導体の
高密度化・効率化に貢献するシンタリング装置をご提案～

半導体用シンタリング装置の世界最大手メーカーであるBoschman社（本社：オランダ）と、金属接合を事業の核とするエンジニアリング商社である株式会社進和（本社：名古屋市）が、シンタリング事業で協業することになりました。

今回の協業は、“パワー半導体を次のステージへ”をキーワードに、パワー半導体の高密度化、効率化、小型化の実現を目指したものです。

効率的な熱伝導と、ダイナミックインサート技術により、より広範囲なエリアへのシンタリングが可能なBoschman社製のシンタリング装置を、進和のトライセンターにて試作から試作品評価、装置の導入まで幅広くサポートいただけます。

東京ビッグサイトにて開催される、ネプコンジャパン2025（2025/1/22～1/24）では、Boschman社のシンタリング装置が展示されます。

今後もBoschman社との協業を通じて、次世代のものづくりに寄与してまいります。

■トライ・試作までの流れ



進和 メカトロシステムセンター（MEC）
春日井事業所

〒486-0821
愛知県春日井市大泉町501

Boschman (Netherlands) and Shinwa Collaborate on Sintering Business for Next-Generation Semiconductors.

～ Proposing Sintering Equipment that Contributes to the High Density and Efficiency of Power Semiconductors through SiC/GaN Semiconductors and Sintering Bonding ～

Boschman, the world's largest manufacturer of sintering equipment for semiconductors (headquartered in the Netherlands), and Shinwa Co., Ltd., an engineering trading company specializing in metal bonding (headquartered in Nagoya), have decided to collaborate in the sintering business.

This collaboration aims to advance power semiconductors to the next stage, focusing on achieving higher density, efficiency, and miniaturization of power semiconductors. Boschman's sintering equipment, which enables sintering over a wider area thanks to efficient heat conduction and dynamic insert technology, will be widely supported at Shinwa's Try Center, from prototyping to prototype evaluation and equipment introduction.

Boschman's sintering equipment will be exhibited at NEPCON Japan 2025, held at Tokyo Big Sight from January 22 to January 24, 2025. Through our ongoing collaboration with Boschman, we will continue to contribute to the next generation of manufacturing.

■ Trial Flow



Shinwa Mechatronics System Center
Kasugai Office

501, Daisenji-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0812